



Processor Intel® Core™ i3-6100

pamięć podręczna 3 MB, 3,70 GHz

Niezbędne zasoby

- Kolekcja produktów [Procesory Intel® Core™ i3 szóstej generacji](#)
- Nazwa kodowa [Nazwa Skylake poprzednich produktów](#)
- Segment rynku pionowego Desktop
- Numer procesora i3-6100
- Stan Launched
- Data rozpoczęcia Q3'15
- Litografia 14 nm
- Obejmuje elementy Thermal Solution - E97379
- Rekomendowana cena klienta \$117.00
- Warunki użytkowania Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet

Wydajność

- Liczba rdzeni 2
- Liczba wątków 4
- Bazowa częstotliwość procesora 3,70 GHz
- Cache 3 MB SmartCache
- Szybkość magistrali 8 GT/s DMI3
- TDP 51 W

Informacje uzupełniające

- Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych Tak
- Dane katalogowe [Wyświetl teraz](#)

Dane techniczne pamięci

- Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci) 64 GB
- Rodzaje pamięci DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
- Maks. liczba kanałów pamięci 2
- Maks. przepustowość pamięci 34,1 GB/s
- Obsługa pamięci ECC † Tak

Grafika wbudowana w procesor

- Układ graficzny procesora † Intel® HD Graphics 530
- Częstotliwość podstawowa układu graficznego 350 MHz
- Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 1,05 GHz
- Maks. pamięć wideo układu graficznego 64 GB
- Wyjście do grafiki eDP/DP/HDMI/DVI

- Obsługa 4K Yes, at 60Hz
- Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz
- Maks. rozdzielczość (DP)‡ 4096x2304@60Hz
- Maks. rozdzielczość (eDP – wbudowany płaski wyświetlacz)‡ 4096x2304@60Hz
- Maks. rozdzielczość (VGA)‡ N/A
- Obsługa DirectX* 12
- Obsługa OpenGL* 4.5
- Intel® Quick Sync Video Tak
- Technologia Intel® InTru™ 3D Tak
- Technologia Intel® Clear Video HD Tak
- Technologia Intel® Clear Video Tak
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy † 3
- Identyfikator urządzenia 0x1912

Opcje rozszerzeń

- Skalowalność 1S Only
- Wersja PCI Express 3.0
- Liczba konfiguracji PCI Express † Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
- Maksymalna liczba linii PCI Express 16

Specyfikacja obudowy

- Obsługiwane gniazda FCLGA1151
- Maks. konfiguracja procesora 1
- Specyfikacja systemu Thermal Solution PCG 2015C (65W)
- T_{CASE} 65°C
- Wymiary obudowy 37.5mm x 37.5mm

Technologie zaawansowane

- Obsługa pamięci Intel® Optane™ † Nie
- Technologia Intel® Turbo Boost † Nie
- Intel® vPro™ — kryteria kwalifikowalności platformy † Nie
- Technologia Intel® Hyper-Threading † Tak
- Technologia Intel® Virtualization (VT-x) † Tak
- Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) † Tak
- Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) † Tak
- Intel® TSX-NI Nie
- Intel® 64 † Tak
- Zestaw instrukcji 64-bit
- Rozszerzony zestaw instrukcji Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
- Stany beczynności Tak
- Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Tak
- Technologie monitorowania chłodzenia Tak
- Technologia Intel® ochrony tożsamości † Tak
- Program stabilnych platform firmy Intel® ułatwiających pracę administratorom Nie

Niezawodność i bezpieczeństwo

- Intel® AES New Instructions Tak
- Secure Key Tak
- Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) Tak

- Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) Tak
- Intel® OS Guard Tak
- Technologia Intel® Trusted Execution † Nie
- Funkcje Execute Disable Bit † Tak
- Intel® Boot Guard Tak